

北京天科合达半导体股份有限公司 关于 2018 年第一次股票发行方案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-064），该发行方案中对本次募集资金用途部分内容披露不充分，现补充修订如下：

（一）“第三节 前次募集资金使用情况及本次募集资金用途”之“二、本次发行募集资金用途”之“3、募集资金需求测算、投入安排”之“（3）偿还银行贷款”

1、修订前内容

“2018 年 6 月 12 日，招商银行北京分行与公司签订《授信协议》，同意向公司提供人民币 1,500.00 万元授信额度。按照该《授信协议》约定，公司分批次向招商银行北京分行办理贷款共计 1,500.00 万元，具体明细如下：”

2、修订后内容

“2018 年 6 月 12 日，招商银行北京分行与公司签订《授信协

议》，同意向公司提供人民币 1,500.00 万元授信额度。按照该《授信协议》约定，公司分批次向招商银行北京分行办理贷款共计 1,500.00 万元，全部用于采购生产耗材、人员薪酬、厂房租金等日常生产经营支出。贷款具体明细如下：”

（二）“**第三节 前次募集资金使用情况及本次募集资金用途**”之“**二、本次发行募集资金用途**”之“**3、募集资金需求测算、投入安排**”之“**（3）偿还银行贷款**”

修订前内容

“为缓解公司日常经营中的资金压力、推动公司业务发展，公司向股东上海汇合达借入资金用于日常费用开销及订购产品生产设备。根据双方《借款协议》和公司 2017 年度《审计报告》，截至 2017 年末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,051,114.68 元；根据《借款协议》和公司 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表，截至 2018 年 6 月末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币 11,259,207.58 元。截至 2018 年 12 月 10 日，公司尚未向上海汇合达偿还借款本金及利息。”

修订后内容

“为缓解公司日常经营中的资金压力、推动公司业务发展，2007 年至 2009 年，公司陆续向股东上海汇合达借入资金 1,566.33 万元，全部用于子公司新疆天科合达购置厂房用地、厂房建设、购置生产设备。

根据双方《借款协议》和公司 2017 年度《审计报告》，截至 2017

年末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币11,051,114.68元；根据《借款协议》和公司2018年1-6月未经审计的财务报表，截至2018年6月末，公司应付上海汇合达借款本金和利息合计人民币11,259,207.58元。截至2018年12月10日，公司尚未向上海汇合达偿还借款本金及利息。”

（三）“第三节 前次募集资金使用情况及本次募集资金用途”之“二、本次发行募集资金用途”之“4、本次募集资金用于偿还银行贷款和股东借款符合相关监管要求”

修订前内容

无相关内容。

修订后内容

“4、本次募集资金用于偿还银行贷款和股东借款符合相关监管要求

公司计划使用本次募集资金偿还招商银行贷款和股东上海汇合达借款，其中招商银行贷款全部用于采购生产耗材、人员薪酬、厂房租金等日常生产经营支出，股东上海汇合达借款全部用于子公司新疆天科合达购置厂房用地、厂房建设、购置生产设备。拟偿还的银行贷款和股东借款的用途均为日常经营用款，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资情况，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司情况，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情况；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情况；

不存在用于投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事房地产开发业务的情况，不存在购置工业楼宇或办公用房的情况，不存在宗教投资的情况，贷银行款及股东借款用途满足《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关监管要求。

（四）“第三节 前次募集资金使用情况及本次募集资金用途”之“二、本次发行募集资金用途”之“4、本次募集资金用于偿还银行贷款和股东借款符合相关监管要求”

修订前内容

“4、本次发行募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，公司已建立募集资金管理的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放和收付，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后将与存放募集资金的商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。”

修订后内容

“5、本次发行募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，公司已建立募集资金管理的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放和收付，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后将与存放募集资金的商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。”

（五）“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、使用募集资金购买非股权资产对公司资产质量及持续经营能力的影响”、“四、使用募集资金购买非股权资产不构成重大资产重组”

修订前内容

无相关内容。

修订后内容

“三、使用募集资金购买非股权资产对公司资产质量及持续经营能力的影响

本次募集资金用途中包括购买生产设备和无形资产等非股权资产，其中 3,000.00 万元用于采购生产设备，1,021.81 万元用于收购股东中科院物理所单独持有及与公司共有的 26 项专利技术。通过购买上述非股权资产，将对公司资产质量和持续经营能力产生积极影响。

募集资金采购生产设备将对公司资产质量和持续经营能力产生积极影响。随着下游集成电路行业投资日益旺盛，国内碳化硅晶体、晶片产品呈现供不应求的态势，公司目前产能难以满足客户订单需求。通过采购晶体生长、加工、清洗、检测等生产设备，将有效提升公司

产品产能，对公司提高产品市场占有率和产品竞争力、增强持续经营能力奠定坚实基础。

募集资金购买无形资产将对公司资产质量和持续经营能力产生积极影响。公司主要产品为碳化硅晶体和晶片，晶体生长、多线切割、研磨抛光、清洗封装。公司计划向中科院物理所收购 26 项专利（含 1 项专利申请），具体涉及碳化硅晶体生长相关专利 13 项，晶体切割相关专利 1 项，研磨抛光相关专利 7 项，晶片清洗相关专利 1 项，产品性能及应用相关专利 4 项。因此，拟购买的专利与公司现有主营业务完全相关，收购完成后将有效提升公司的技术储备和产品质量，对公司的盈利能力和持续经营能力产生积极影响。

四、使用募集资金购买非股权资产不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理”。

第三十五条规定，“（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相

关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。（四）公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

2017年末，公司经审计的合并报表资产总额为16,256.48万元。公司本次募集资金向不同厂家采购生产设备金额合计3,000.00万元，向股东中科院物理所购买无形资产1,021.81万元，非股权资产的资产总额为4,021.81万元，公司购买非股权资产不涉及12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形，以上非股权资产均不涉及负债，资产账面值与成交金额相同。本次募集资金购买非股权资产占2017年末公司经审计的合并报表资产总额比例为24.74%，不存在购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上的情形，不构成重大资产重组。”

（五）“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
之“三、使用募集资金购买非股权资产对公司资产质量及持续经营能

力的影响”、“四、使用募集资金购买非股权资产不构成重大资产重组”

修订前内容

“三、本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次发行前，上海汇合达投资管理有限公司持有公司股份 28,296,197 股，持股比例 27.30%，为公司控股股东；新疆天富集团有限责任公司持有上海汇合达投资管理有限公司 100.00% 股权，间接持有公司股份 28,296,197 股，间接持股比例 27.30%；新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会持有新疆天富集团有限责任公司 77.03% 股权，为公司实际控制人。

本次发行完成后，上海汇合达投资管理有限公司持有公司股份 28,296,197 股，持股比例 17.40%，仍为公司第一大股东；新疆天富集团有限责任公司直接持有公司股份 16,107,970 股，直接持股比例 9.90%；新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会间接持有公司股份 44,404,167 股，间接持股比例仍为 27.30%，仍为公司实际控制人。

因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

四、与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。”

修订后内容

“五、本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次发行前，上海汇合达投资管理有限公司持有公司股份

28,296,197 股，持股比例 27.30%，为公司控股股东；新疆天富集团有限责任公司持有上海汇合达投资管理有限公司 100.00% 股权，间接持有公司股份 28,296,197 股，间接持股比例 27.30%；新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有新疆天富集团有限责任公司 77.03% 股权，为公司实际控制人。

本次发行完成后，上海汇合达投资管理有限公司持有公司股份 28,296,197 股，持股比例 17.40%，仍为公司第一大股东；新疆天富集团有限责任公司直接持有公司股份 16,107,970 股，直接持股比例 9.90%；新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会间接持有公司股份 44,404,167 股，间接持股比例仍为 27.30%，仍为公司实际控制人。

因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

六、与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。”

二、其他相关说明

除上述补充披露内容外，《2018 年第一次股票发行方案》的其他内容均未发生变化，更正披露后的《2018 年第一次股票发行方案》将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公司对上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年12月14日